



セミナー「航空機材料の将来展望」

－次世代構造部材創製・加工技術開発プロジェクトの成果報告－

ご 案 内

主 催 : 財 団 法 人 素 形 材 セ ン タ ー
次 世 代 材 料 技 術 室

(財)素形材センター 次世代材料技術室は、平成20年度より経済産業省から委託された次世代構造部材創製・加工技術開発に関する2つの研究を実施しています。一つは将来の航空機構造への適用が期待されるチタン合金の材料・プロセス技術の開発、他一方は前プロジェクトで基盤技術を確立した複合材構造健全性診断技術の航空機構造への適用技術の開発であり、それぞれ5か年計画で実施しています。H23年度は5年間のプロジェクトの4年目に当たります。

この度、本成果報告につきまして、下記プログラムによるセミナーを企画いたしました。つきましては、ご多忙中とは存じますが、航空機産業の皆様のみならず、自動車、電気機器等のユーザ産業の皆様におかれましても、新規部品開拓等のご参考になるものと存じますので、多数ご参加下さいますよう、ご案内申し上げます。

📌 開催概要

- と き 平成24年1月13日(金) 13:00～16:50
(受付開始: 12:30)
- と ころ 機械振興会館地下2階 B2-1会議室 (東京都港区芝公園3丁目5番8号) (案内図参照)

📌 プログラム

挨拶 13:00～13:10
荻布 真十郎
(財)素形材センター 次世代材料技術室長

◆講演 ー成果報告ー

- 司会 榎本 清志
(財)素形材センター 次世代材料技術室 航空機材料技術部
1. プロジェクト紹介・複合材構造健全性診断技術開発 13:10～13:55
吉田 幹夫
(財)素形材センター 次世代材料技術室 航空機材料技術部
 2. プロジェクト紹介・次世代チタン合金構造部材創製・加工技術開発 13:55～14:40
磯江 暁
(財)素形材センター 次世代材料技術室 航空機材料技術部
 3. 今後の研究開発課題 14:40～15:00
磯江 暁
(財)素形材センター 次世代材料技術室 航空機材料技術部

***** (休 憩 15:00～15:10) *****

◆特別講演

- 「テキストイル・プリフォームの複合材料への適用動向調査」 15:10～16:00
京都大学 教授 北條 正樹
- 「航空機用複合材構造の現状と課題・今後の方向性」 16:00～16:50
(独)宇宙航空研究開発機構 理事 石川 隆司

なお、セミナー後、機械振興会館内において簡単な懇親会を準備しております。セミナーでの話題に関する意見交換もできますので、奮ってご参加ください。

参加要領

- 定 員 80名 (申込順に受け付け、定員になり次第締め切ります)
- 参加費 (セミナー) 次世代材料技術室賛助会員 無 料
 その他 5,000円 (消費税込み)
 (懇親会) 2,500円 (消費税込み)



■ 申込方法、お問い合わせ先

下記申込書に所要事項記入の上、郵送もしくは FAX でお申込み下さい。申し込み受付は E-mail 宛にご連絡いたします。

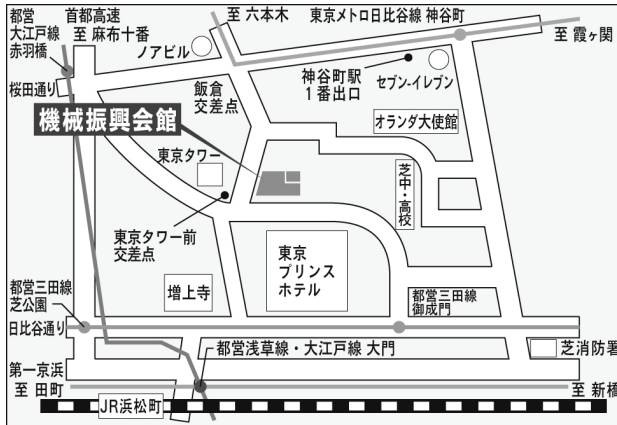
〒105-0011 東京都港区芝公園 3 丁目 5 番 8 号 機械振興会館 2 階 202-2 号室
 財団法人 素形材センター 次世代材料技術室 航空機材料技術部 (担当: 磯江)
 電話 03(3459)6900 FAX03(3459)6911

■ 参加費のお支払い

参加申込後、別途ご請求させていただきます (領収書を必要とされる場合は、申込書にその旨をご記入ください)。
 (振込み手数料は、ご負担願います)

■ 申込締切 平成 24 年 1 月 6 日(金)

《会場案内図》



地下鉄: 東京メトロ日比谷線神谷町駅下車(徒歩 8 分)、都営三田線御成門駅下車(徒歩 10 分)、都営大江戸線赤羽橋駅下車(徒歩 10 分)、都営浅草線大門駅下車(徒歩 15 分)
JR: 浜松町駅下車(徒歩 17 分)
バス: 浜松町～東京タワー路線東京タワー前下車

個人情報保護法に関する対応

ご記入頂いた個人情報は、本セミナーの事務に利用するとともに、参加者リストを作成し、講師に手交します。
 また、素形材センターの行う各種研修、セミナー、出版物、事業の案内状の送付に利用する予定です。今後、素形材センターが行う素形材産業の実情に関する調査アンケートへの協力依頼を行う場合もあります。

(※ 会場では、一切の録音、録画をお断りします。予めご了承下さい。)

申 込 書

(財)素形材センター 次世代材料技術室 航空機材料技術部 磯江宛 (FAX 03-3459-6911)

セミナー「航空機材料の将来展望」

一次世代構造部材創製・加工技術開発プロジェクトの成果報告

(24 年 1 月 13 日開催)

| | | | | |
|--------|---|-----------------|----------|----------|
| 参加者氏名 | | | | |
| 機関名 | | 部署名 | | |
| 住所 | 〒 | | | |
| 電話 | | 出 欠 ○で囲んで下さい | セミナー | 懇親会 |
| FAX | | | 次世代室賛助会員 | 参加 ・ 不参加 |
| E-mail | | | ・ その他 | |
| 備考 | | | | |

(セミナー) 次世代材料技術室賛助会員: 無 料 / その他: 5,000円 (消費税込み)
 (懇親会) 2,500円 (消費税込み)

金額 _____ 円也、上記のとおり参加いたしますので、申し込みます。

年 月 日